

青岛青软晶尊微电子科技有限公司

2025年度应届生岗位需求

企业介绍

青岛青软晶尊微电子科技有限公司，是具有五千颗芯片设计经验的集成电路设计服务与教育培训的公司，公司以青岛总部为中心，部署成立南京青软晶尊、安徽青软晶芒及上海青软晶睿公司，辐射长三角经济带，多点带线形成东部沿海发展网络，打造国内一流的集成电路设计服务与教育培训基地。同时借助台湾业务平台，开拓国际业务，积极部署国际化发展战略。

青软晶尊集成电路设计服务始于 1996 年，为国内较早从事集成电路设计服务的企业，团队 20 余年时间里为客户提供 5000 余颗芯片的设计服务，产品涵盖 DDR 存储类芯片、RFIC、MCU、电源管理、LCD/OLED 液晶驱动、蓝牙耳机 IC 等不同功能芯片，工艺制程涵盖 TSMC、GF、UMC、SMIC、DB、XFAB 等主流工艺厂商 500nm~7nm 之间的各类工艺。公司依据高品质的设计服务能力，在美国、日本、中国台湾及大陆积累了长期、稳定的客户群体，如 Ti、AMD、TOSHIBA、TSMC、MTK、小米、字节跳动、长鑫存储等全球知名集成电路企业。

青软晶尊集成电路教育培训业务始于 2006 年，为国内与高校进行集成电路方向专业共建、学院共建的领先企业，公司利用平台+内容+服务的模式助力高校集成电路人才培养，目前全国合作院校二百余所，进行专业共建，学院共建等深入合作院校五十余所，为集成电路产业培养输送了万余名优秀工程师。被认定为工信部集成电路人才培养工程培训基地，人社部集成电路工程技术人员考核站点。

公司荣获国家专精特新小巨人企业、高新技术企业、技术先进型服务企业、专精特新示范企业、山东省瞪羚企业等荣誉称号。

招聘岗位

一、IC 模拟后端设计师（若干，转正后薪资：7K-8K）

职位描述：

1. 负责版图布局和设计的相关工作；
2. 负责版图物理验证（包括 DRC、LVS、ERC、ANT），完成寄生参数提取，提供 LEF、GDS 等相关数据；
3. 能与工程师紧密合作，完成版图性能优化；
4. 完成电路版图设计 tapeout、Jobview 等相关工作；
5. 负责项目相关技术文档的撰写，包括设计评审报告、工艺信息核准单、人工版图检查清单。

任职要求：

1. 本科及以上学历，集成电路、微电子、电科、电子信息等相关专业，硕士优先考虑；
2. 有版图设计学习或实习经验；
3. 了解和熟悉混合信号芯片版图设计流程，熟练掌握 Calibre LVS/DRC；
4. 熟悉 cmos/bicmos/bipolar/bcd 工艺、层次及器件；能做 whole chip 规划
5. 熟练使用 Cadence 布局布线工具，了解高频、低噪声、高对称性等条件下的版图设计；
6. 熟悉 Latch-up、ESD、天线效应在版图设计中的解决方案；
7. 有多次全定制 IC 产品 tape-out 经验优先。

二、IC 数字数字后端设计师（若干，转正后薪资：7K-8K）

岗位职责：

1. 负责 ASIC&SoC Top/Block 的 Netlist 到 GDS Tapeout 的后端相关工作；
2. 包括 FloorplanPlace CTS Route；
3. 包括 BUMP/RDL 设计和对接封装设计与PI/SI 设计；
4. 包括 STA 时序优化收敛和检查；
5. 包括芯片 Sign-Off 验证检查工作:DRCLVSIR-DropPower 分析等。

任职要求：

1. 集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术等本科及以上学历，相关专业硕士优先考虑；
2. 熟悉 Linux 开发环境及常用 Linux 下文本编辑工具，熟悉 csh、tcsh、

MakefileTCLperl 和 python 等语言者优先;

3. 熟悉 InnovusPrimeTime 等 EDA 工具, 精通 CTS 和时序修复等;
4. 熟练使用 calibre/skiper/laker 等工具, 具有全芯片 PV 经验, 并成功 tapeout 者优先;
5. 具有 40nm 及更先进工艺经验、SOCTop 的芯片流片经验、熟悉 DDR、PCIe、Serdes 等 IP 经验者优先;
6. 认真的工作态度, 良好的工作积极性和责任心。

联系方式:

李克坚 18953218086 (微信同号)

简历投递邮箱:

likj@itshixun.com